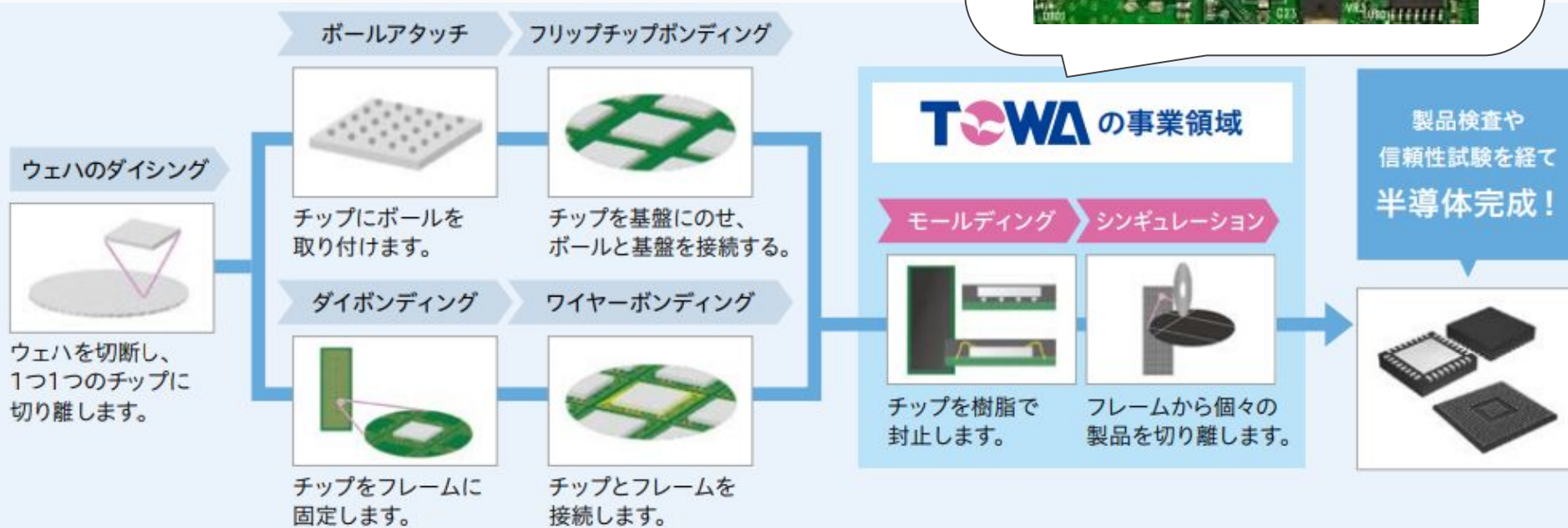


TOWA(6315)



TOWAの装置で半導体をカバー



全自動半導体樹脂封止装置の中に 超精密金型が組み込まれている



最先端半導体の樹脂封止に最適な
コンプレッション成形装置

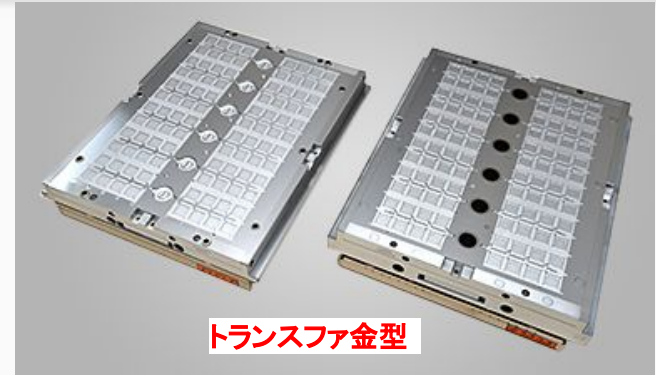
ごく狭い隙間にも、気泡なく完全に樹脂を
充填させるために、コンプレッション成形
装置が活躍します。

生成AI向けHBMの業界初の
量産装置



2.5D/3D/チップレット製品に最適な
トランスファモールディング装置
Model YPM1250-EPQ

チップレット製品に対応した業
界初の装置

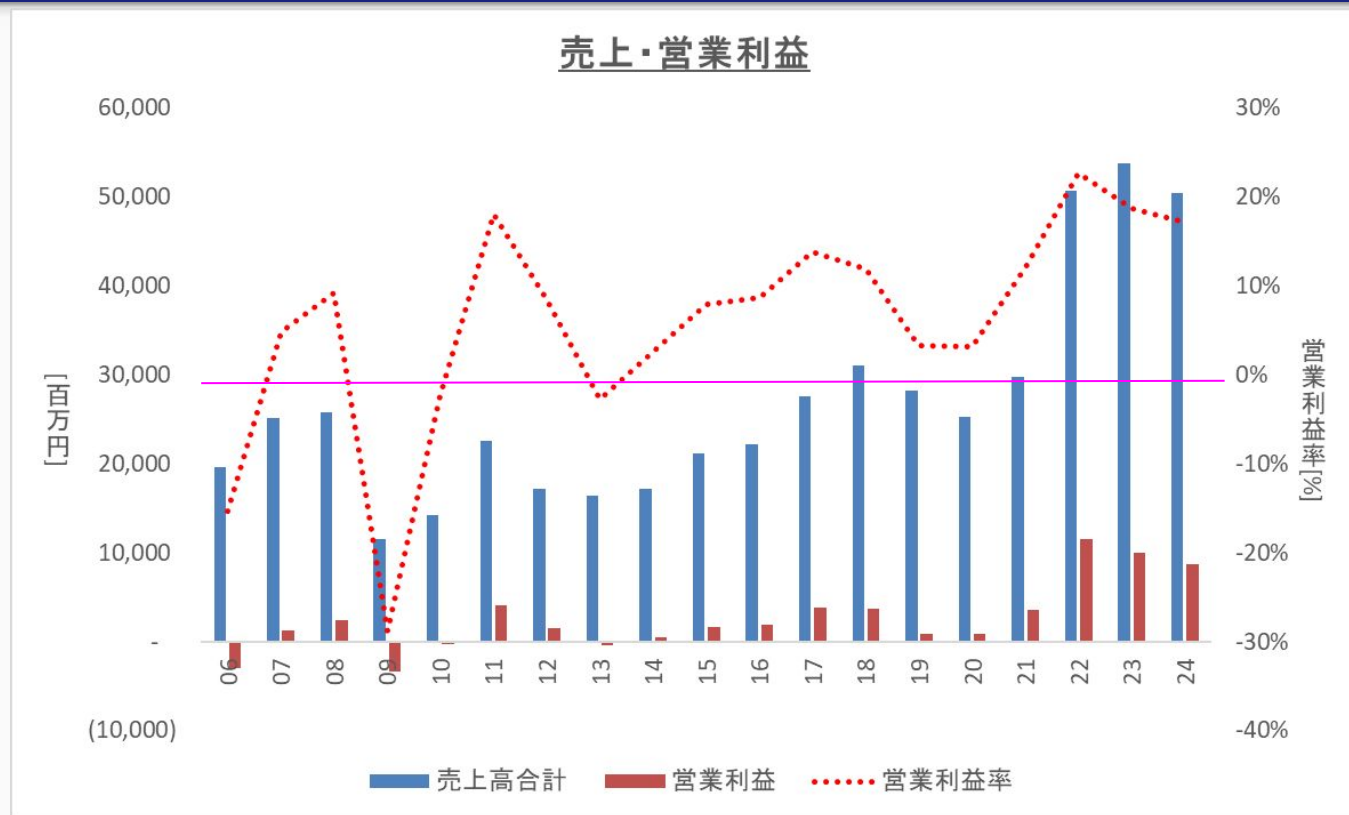


トランスファ金型



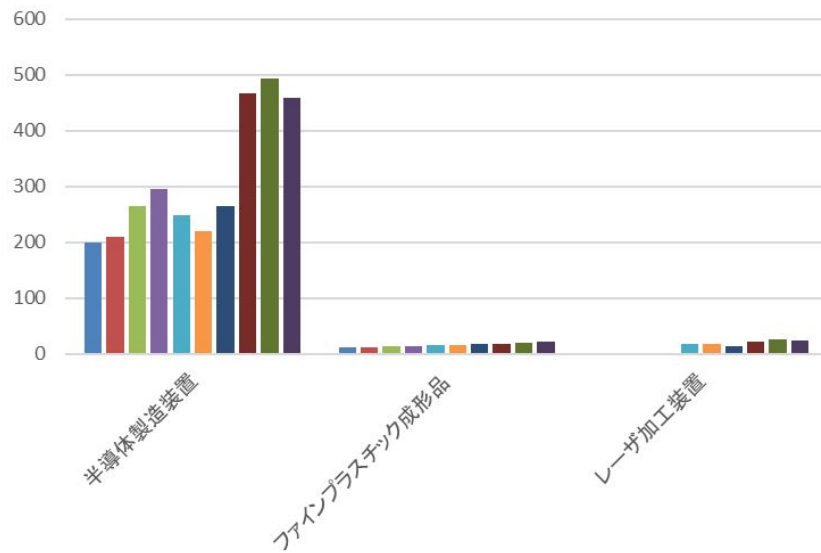
コンプレッション金型

業績は乱高下を繰り返しながらも、近年は急上昇

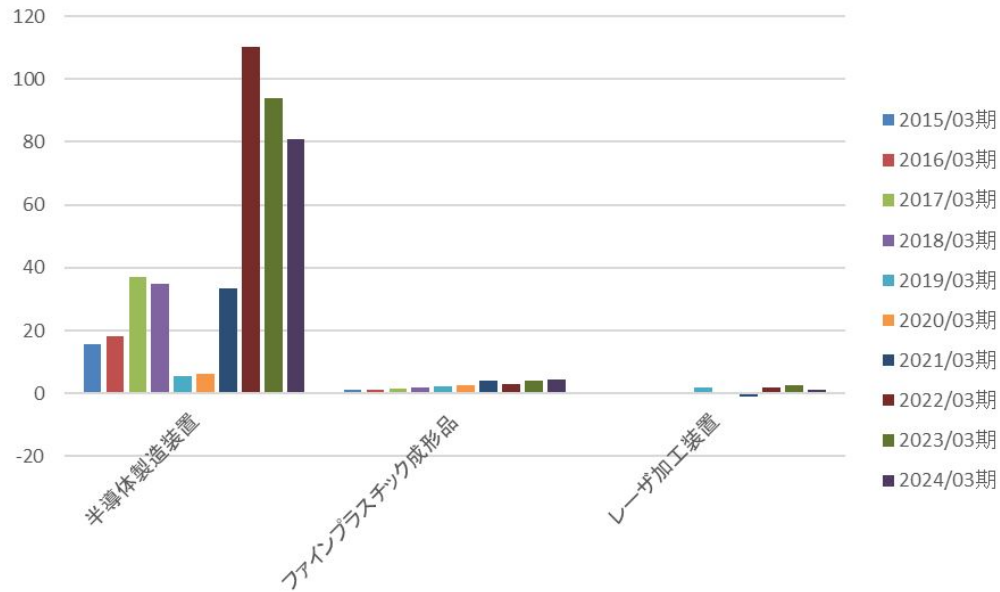


セグメント別

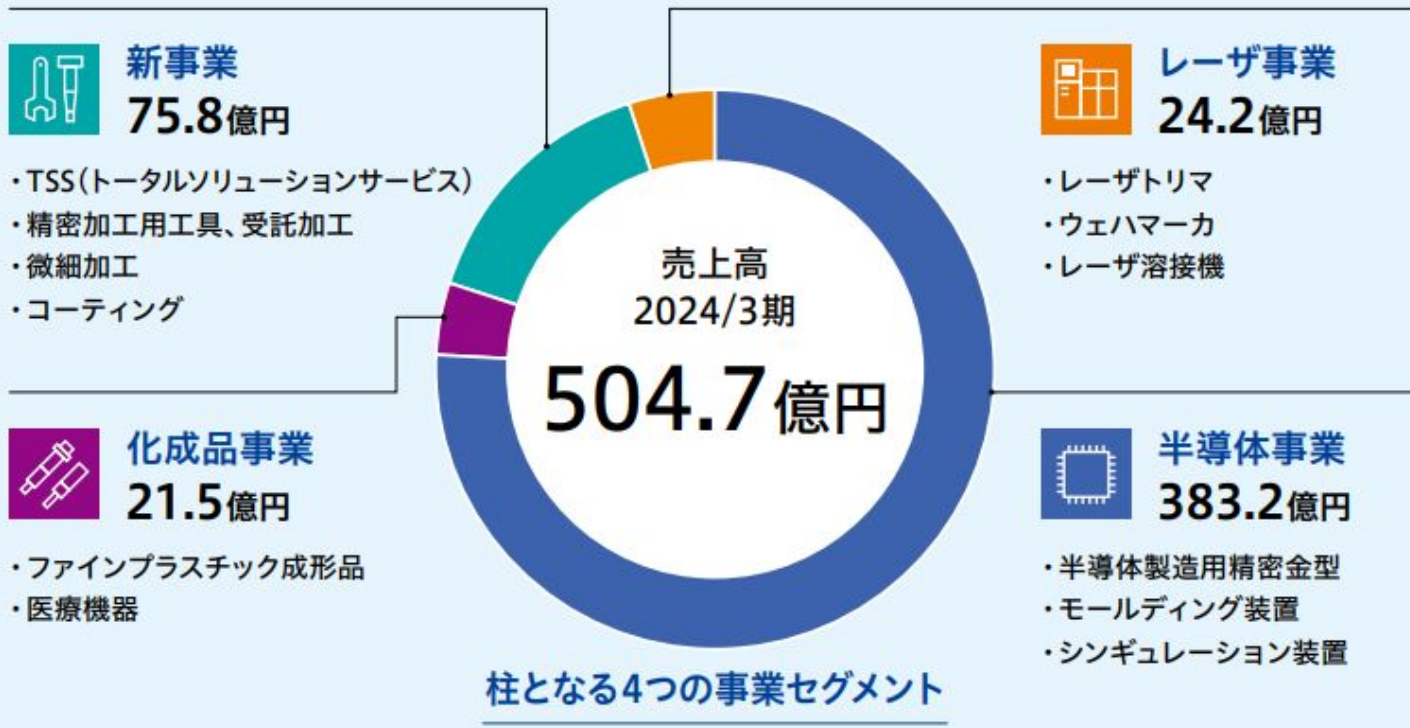
セグメント別売上(億円)



セグメント別利益(億円)



半導体事業がメイン



半導体事業 内訳

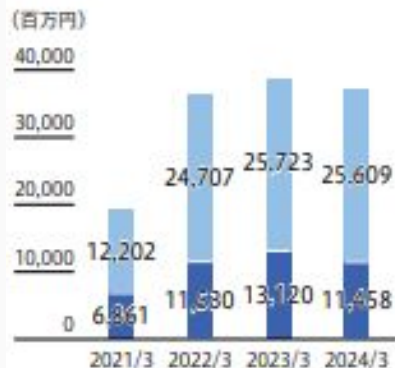
半導体製造用等 精密金型



モーディング 装置

民生品向け投資が低迷し売上高は減少したものの、生成AI関連向けにコンプレッション装置の需要が拡大し、通期のコンプレッション装置、金型の受注高と売上高は過去最高に。

売上高



受注高



■ 半導体製造用等精密金型 ■ モーディング装置

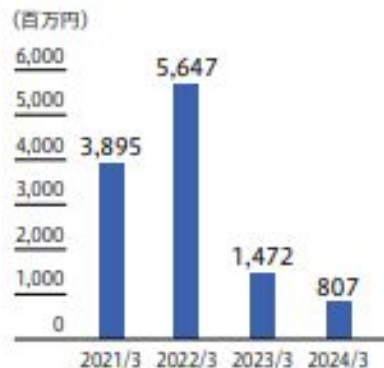
シンギュレーション装置

調整局面にて売上高が減少する中、開発・生産・営業部隊を備えた事業本部体制に移行。専門体制により、市況回復と同時にシェア拡大を目指す。

売上高

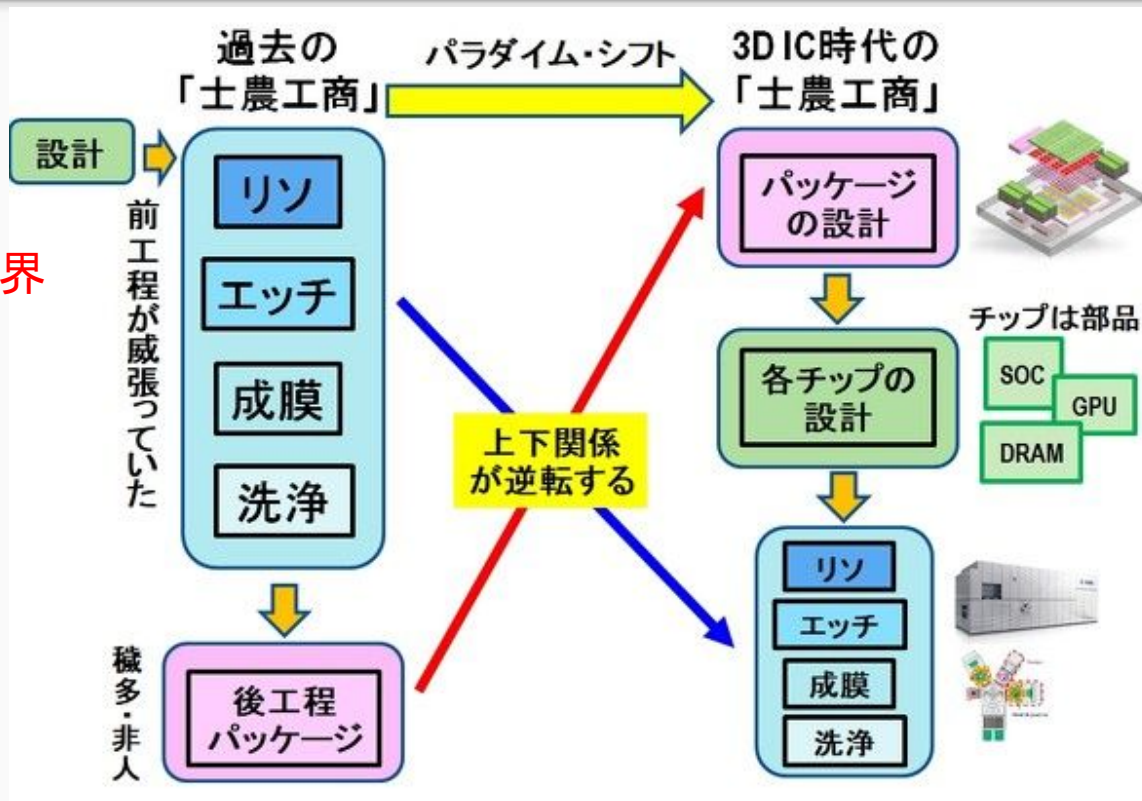


受注高



■ シングュレーション装置

AI半導体、チップレット需要の高まりで、 後工程のモールドディング技術にも注目が高まる



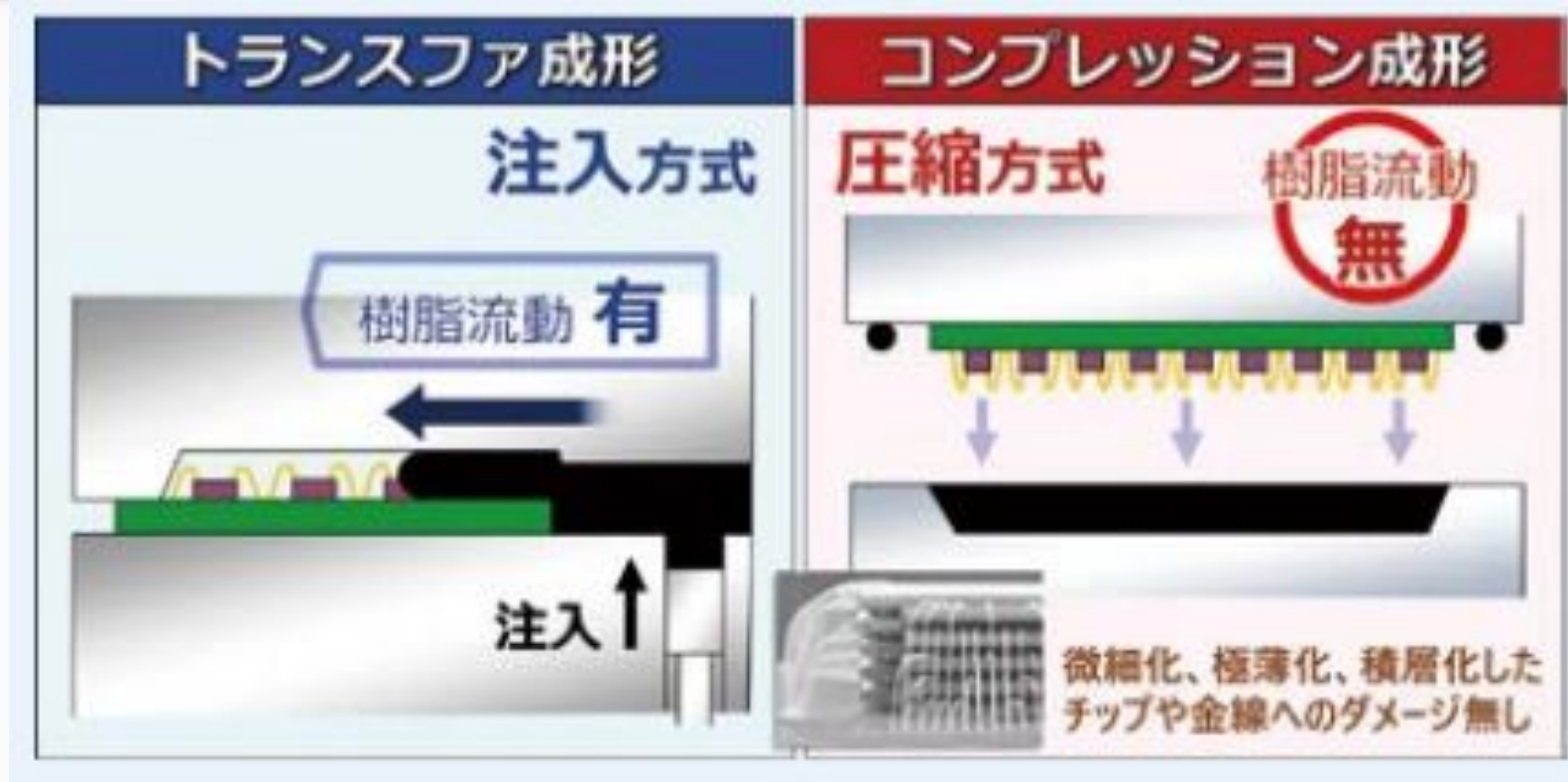
- ・微細化の限界
- ・研究開発の高コスト化

- 下記技術に注目
- ・チップレット
 - ・パッケージング

AI半導体に活用

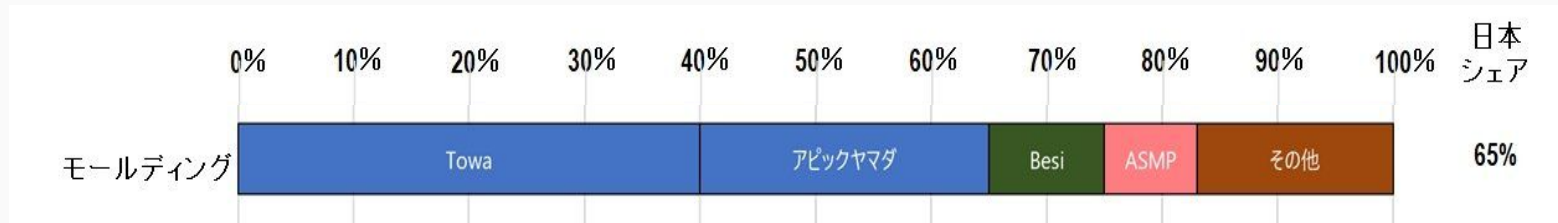
出典:EE TIMES

微細化、極薄化、積層化したチップ向けの モールドディング装置に強み



モールドイング装置のシェアは年々高まる

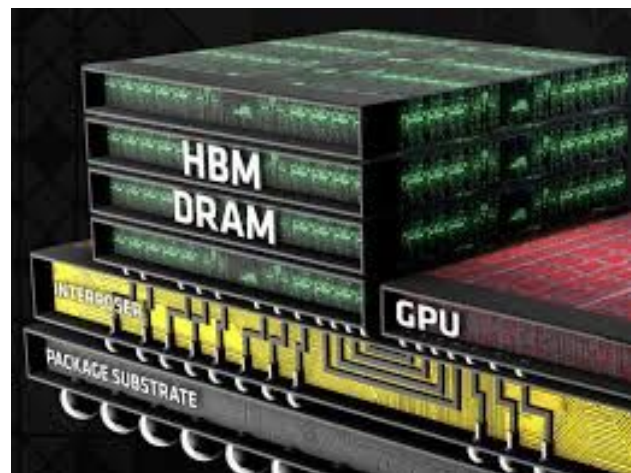
2019年頃



数字で見る
TOWAの現在地

半導体モールドイング
装置世界シェアの推移





2D

2.5D

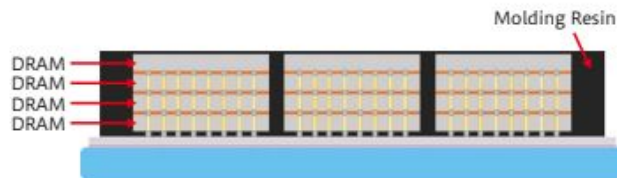
3D



HBM、2.5D実装などの最先端半導体プロセスにおける当社製品の役割

最先端半導体には様々な製造プロセスや工程があります。当社製品の貢献事例を紹介します。

超高速メモリ
HBMの
樹脂封止



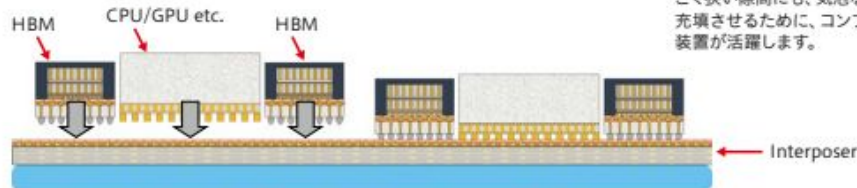
HBMの断面イメージ(2.5D実装前)



Model CPM1080

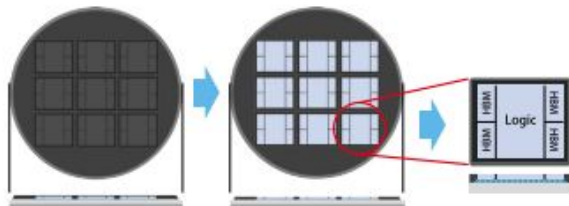
最先端半導体の樹脂封止に最適な
コンプレッション成形装置

ごく狭い隙間にも、気泡なく完全に樹脂を
充填させるために、コンプレッション成形
装置が活躍します。



インターポーザ上に異種チップが集積された2.5D実装(CoW)のイメージ

2.5D実装
(CoW: Chip on
Wafer)と
樹脂封止



封止工程後

研磨工程後

個片化後のイメージ

コンプレッション成形装置で封止した成形品は、チップを
露出させるための研磨工程などを経て個片化されます。

個片化



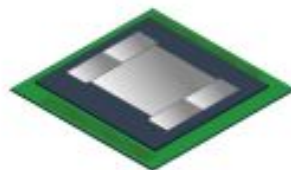
Model FMS4040

自動化・品質向上に貢献する
シングュレーション装置

実装基板は、シングュレーション装置で
切断されます。

基板実装・
樹脂封止

YPM1250-EPQは、基板に配置された複数のチップレット製品の樹脂封止化において、生産性向上、高品質化のソリューションを提案しています。



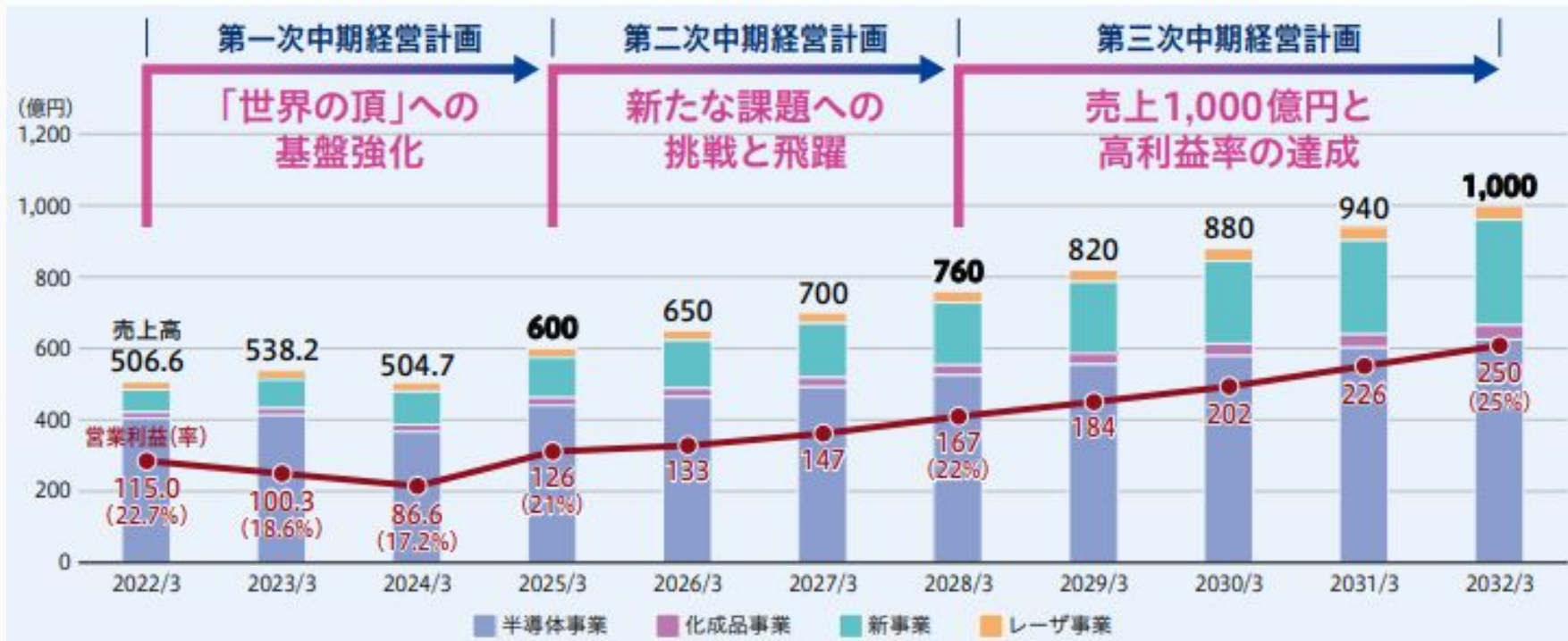
チップレット製品のイメージ



Model YPM1250-EPQ

今は成長に向けた準備期間

変革で世界の頂へ



TOWAが約23年ぶり高値、積層半導体向け封止装置開発と報じられる

TOWA<[6315](#)>が2000年9月以来の高値となっている。きょう付の日本経済新聞朝刊で「データセンターの効率的な運用などを目指して複数の半導体を1つにまとめる封止装置を開発した」と報じられており、好材料視されている。

記事によると、新製品は機能が異なる半導体をブロックのように組み合わせる「チップレット」と呼ぶ技術に対応。台湾積体電路製造（TSMC）に出荷するとしており、業績への貢献が期待されている。

出所：[MINKABU PRESS](#)

TOWAが続急騰で上場来高値更新、生成A I 向けの後工程特需獲得に期待

TOWA<[6315](#)>が続急騰。前日は日経平均株価が650円あまりの急落となり、半導体関連株も軒並み大きく売られるなかにあって、同社株は205円高の5100円でほぼ高値引けとなる異色の上げ足をみせていた。きょうも上値追いを加速させ一時330円高の5430円まで駆け上がり、上場来高値を更新した。モールディング装置（樹脂封止装置）を主力とする後工程担当の半導体製造装置メーカーだが、生成A I の市場拡大に伴う高性能半導体の需要創出によって同社の収益機会が高まっている。高性能半導体は後工程の技術開発が重要な役割を示すが、前工程の製造装置メーカーが多いなか、後工程を手掛ける技術競争力の高いメーカーにファンド筋とみられる実需買いが観測されている。同社はその一角を占める存在で、モールディング装置ではA I チップモジュール向けの需要開拓に動いている。業績面でも25年3月期は営業利益ベースで急回復が見込まれ、それを先取りする形で投資資金が攻勢をかけている。

TOWA---大幅反発、生成AI時代の成長期待企業として国内証券が買い推奨

TOWA<6315>は大幅反発。岩井コスモ証券では投資判断を新規に「A」、目標株価を7800円としている。生成AI関連向けの装置需要は24-25年にかけて本格化が見込まれるとし、生成AI時代に成長が期待できる企業と評価しているようだ。ジェフリーズ証券でも投資判断「バイ」継続で、目標株価を6200円から7700円まで引き上げている。中期的なHBM関連需要の拡大見通しなどを反映のもよう。

《ST》

[提供：フィスコ](#)

TOWA---続落、中期的成長織り込まれたとして米系証券が格下げ

TOWA<6315>は続落。モルガン・スタンレーMUFG証券では、目標株価は8800円から14000円に引き上げているものの、投資判断は「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に格下げしている。HBM関連の伸長など今後の業績展望は明るいものの、足もとまでの株価上昇によって中期的な成長は概ね織り込まれ、今後の株価は保ち合い局面に移行するとみているもよう。27年3月期予想PERは大手半導体製造装置と並ぶ水準としている。

《ST》

[提供：フィスコ](#)

TOWA---大幅反落、第1四半期サプライズ限定的で出尽くし感が優勢に

TOWA<6315>は大幅反落。前日に第1四半期決算を発表している。営業利益は22.1億円で前年同期比2.4倍となったが、26億円程度の市場予想はやや下回る格好に。受注高はほぼ会社ガイダンスレベルでの推移に。ポジティブサプライズが乏しかったことで、本日は出尽くし感が先行する格好となっているようだ。HBM向けの売上高も第1四半期は端境期となって、材料視される形になっていない。

《ST》

[提供：フィスコ](#)

TOWA---急落、受注の下振れ傾向などネガティブ視

TOWA<6315>は急落。前日に上半期の決算を発表、営業利益は52.6億円で前年同期比2.2倍となっているが、従来予想の56.5億円はやや下振れ。通期予想は126億円、前期比45.5%増を据え置いている。7-9月期の受注高は121億円で第1四半期の130億円から減少、従来予想レンジの130-150億円もやや下振れ。また、第3四半期、第4四半期の受注レンジも、従来の150-170億円から120-140億円に引き下げのもよう。

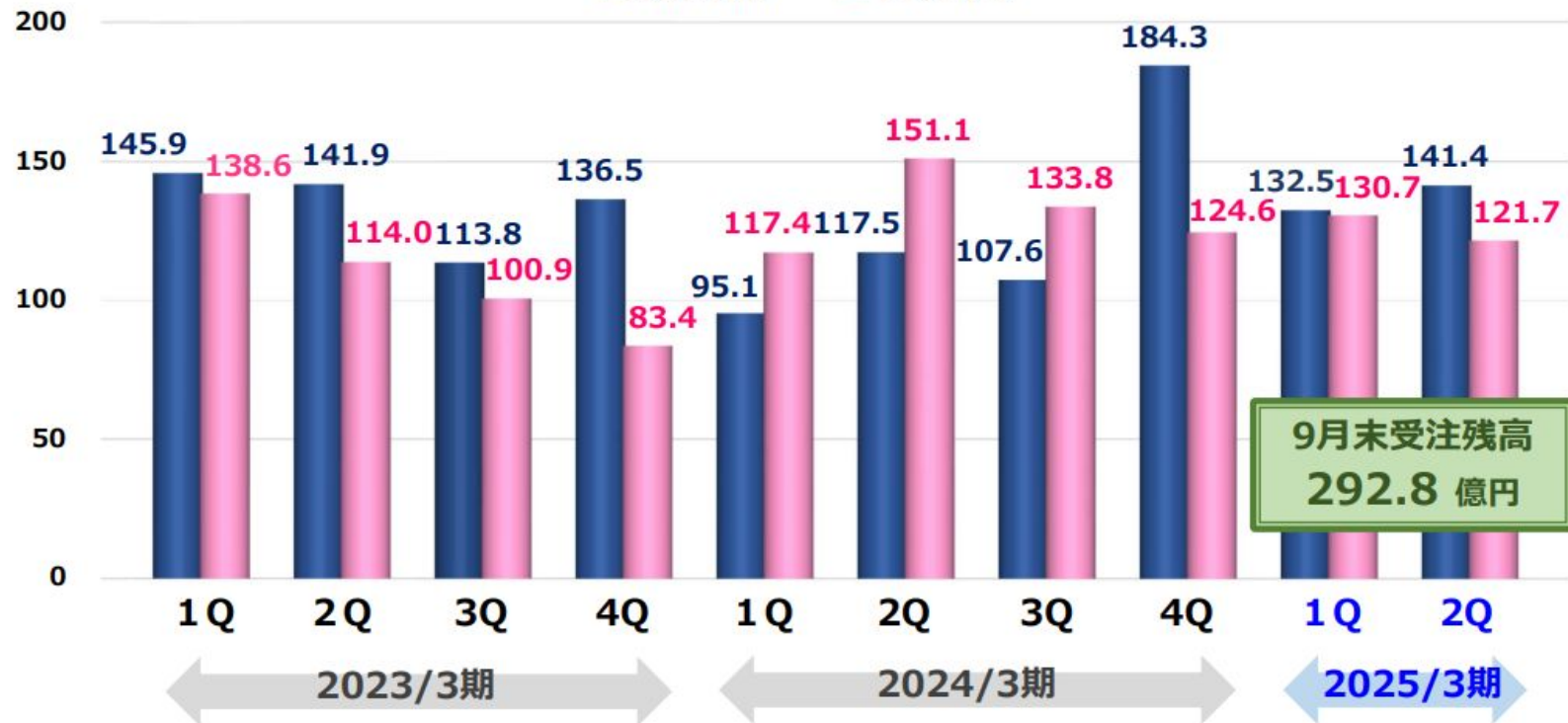
《TY》

[提供：フィスコ](#)

受注・売上高の推移

(単位：億円)

■ 売上高 ■ 受注高



これまでの実績がなかったところからだから、技術プロセスの重要度がわからない
だから四半期ごとの業績に一喜一憂していると思われる